



Deutsche IMAPS Konferenz

10./11. Oktober 2006, München

Call for Papers

Wie bereits Tradition findet die Deutsche IMAPS-Konferenz 2006 an der Technischen Universität in München statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie zu einem der folgenden Themen der *Mikroelektronik*, des *Packaging* bzw. der *Aufbau- und Verbindungstechnik* einen Vortrag von ca. 20 Minuten Dauer halten:

- *Materialien und Technologien*
(Dickschicht, Dünnschicht, LTCC, Advanced PCBs, MCMs, Flip Chip, CSP, COB, SMT)
- *Design und Modellierung*
(Fertigungsgerechtes Design, thermische/mechanische/elektrische Simulation, CAD)
- *Fertigung und Prozesse*
(Large Panel Prozessierung, HDI-Prozesse)
- *Anwendungen*
(HF/Mikrowellenschaltungen, Power Packaging, Kommunikationstechnik, Automobilelektronik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt)
- *Qualität und Zuverlässigkeit*
(Test und Inspektion, Package Zuverlässigkeit, Qualitätsstandards)
- *Umweltaspekte*
(Bleifreie Produkte, Recycling, Umweltverträgliche Materialien)

Bitte senden Sie Ihren Abstract (ca. 200 Wörter) bis zum **26. Mai 2006** an:

Dr.-Ing. Gisela Dittmar, Ingenieurbüro Elektroniktechnologie Dittmar, Egerlandstr. 88, D-73431 Aalen,
Tel. 07361/931129, Fax 07361/943004, gisela.dittmar@imaps.de

Es wird wieder ein BEST PAPER AWARD vergeben !

☞ *Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der Online-Anmeldung unter: <http://www.imaps.de>!* ☞

Neues aus Eureka

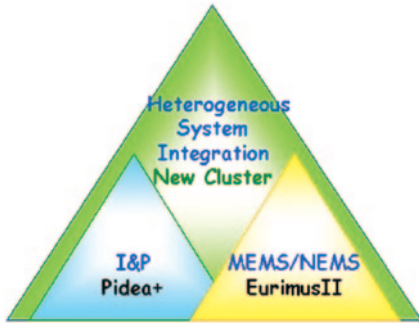
Verschmelzung der Eureka Cluster PIDEA+ und Eurimus II

Seit der Ankündigung der Verschmelzung der beiden Cluster und der ersten gemeinsamen Tagung im Dezember letzten Jahres in Berlin gehen die Vorbereitungsarbeiten der Arbeitsgruppe zügig weiter. Bis Ende März soll ein Strategiepapier vorliegen, das die technologischen Rahmenbedingungen und die Visionen eines des zukünftigen Clusters darstellt und den öffentlichen Fördergremien vorgestellt werden kann.

tigen Clusters darstellt und den öffentlichen Fördergremien vorgestellt werden kann.

EURIPIDs steht für *EUReka Initiative für Packaging und Integration von μ Devices und Smarten Systemen*. Die Mission von EURIPIDs ist:

- die Entwicklung neuer smarterer Systeme auf der Basis von Miniaturisierung, Autonomie, Zuverlässigkeit, niedrigem Energieverbrauch durch Nutzung von Mikro- und Nanosystemen, Aufbau- und Verbindungstechnik sowie Packaging und Test



PLUS

- Stärkung der Marktsituation und der Marktanteile europäischer Unternehmen in wachsenden globalen Markt der anspruchsvollen Systemintegration
- Erweiterung der transnationalen Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedsländern der EU

Hauptschwerpunkte der Heterogenen Systemintegration sind Kombinationen, die Materialien wie Silizium, III-V-Verbindungen sowie Keramik, Polymere, Glas, Textil, Papier etc. funktionell einbinden.

Termine für den 2. Aufruf EURIPIDS (Call for Proposals)

- Launch date: June 2, 2006
- Closing date for PO submission: July 21, 2006
- PO evaluation meeting: September 8, 2006
- Closing date for FPP submission: November 3, 2006
- FPP evaluation meeting: November 29-30, 2006
- FPP labelling meeting: December 1, 2006

Ergebnis zum Aufruf „Smart System Integration“

Der Aufruf zur Einreichung von Projekten mit dem o.g. Schwerpunkt endete am 20. Januar 2006. Insgesamt 12 Projektanträge und Projektskizzen wurden allein bei PIDEA+ eingereicht und zwischenzeitlich von den Experten begutachtet.

Voraussichtlich können alle eingereichten Vorschläge und Skizzen zur Erteilung des Labels empfohlen werden. Die Entscheidungen hierfür werden im nächsten Council meeting am 28. April in Paris fallen.

Besonders positiv aufgefallen ist die steigende Beteiligung deutscher Partner an den Projektvorschlägen.

EURIPIDS-Tag in Paris

Am 27./28. April 2006 findet in Paris ein groß angelegter EURIPIDS-Tag statt.

- EURIPIDS Technical Day, 27. April 2006, an dem die Organisation, Methoden und Erfolgsgeschichten laufender Projekte präsentiert werden
- 28. April 2006: Hauptversammlung der früheren Cluster EURIMUS II und PIDEA, Einigung zur neuen

EURIPIDS-Organisation, Bildung des EURIPIDS-Rates, konstituierende Sitzung

Weitere Informationen hierzu auf www.pidea.com.fr, www.eurimus.com oder bei den Herren *Le Goff* und *Lang*.

yves.legoff@pidea.com.fr, Klaus-Dieter.Lang@izm.fraunhofer.de

Internationale Konferenz/Ausstellung “Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies CICMT”

IMAPS Nordamerika richtet vom 24. bis 27. April 2006 gemeinsam mit der *AcerS (The American Ceramic Society)* die Konferenz *CICMT* aus. Tagungsort ist das Grand Hyatt Regency Hotel in Denver, Colorado. Wie in den vergangenen Jahren werden auch wieder einige deutsche Teilnehmer dort vertreten sein, sei es als Gast, Vortragender oder mit Funktionen in der Konferenz.

Die Veranstaltung spricht insbesondere Interessenten, Entwickler, Hersteller und Nutzer von keramischen Schaltungsträgern und Mikrosystemen an. Darüber hinaus kommen aber auch Besucher aus der Systemsparte bis hin zu Material- und Technologieexperten auf ihre Kosten. Als Auszug aus dem Programm seien hier die Themen der Sessions genannt:

- Materials and Processes for Microsystems
- Co-Firing Processes and Dimensional Control in LTCC
- Microsystems Applications
- Processing and Design of Integrated Passives in LTCC
- Novel Synthesis Technology for Multilayer Electronics
- Direct Write Technology
- Microsystem Materials and Processes
- High Frequency Characterization
- One-on-One Interactive Forum
- International Session on Microsystems

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite www.imaps.org/ceramics. Dort besteht auch die Möglichkeit der Online-Registrierung.

4th European Microelectronics and Packaging Symposium EMPS

Terme Čatež, Slovenia, 21./24. Mai 2006

Im Namen von *IMAPS Slowenien* und *IMAPS Europa* laden wir zum *Europäischen Mikroelektronik- Packaging-Symposium* nach Terme Čatež in Slowenien ein. Die EMPS-Symposien finden nunmehr zum 4. Mal in einem der neuen EU-Länder statt, mit einem Rhythmus von zwei Jahren jeweils zwischen den Kongressen EMPC. Sie sind wichtige Veranstaltungen mit Themen der Integration in der Mikroelektronik. Spezialisten aus der Industrie und der Wissenschaft tauschen sich über „alles in der Elektronik zwischen dem Chip und dem System“ aus.

Das Technische Programm-Komitee hat eine Reihe hochinteressanter Beiträge zu den folgenden Themenkreisen ausgewählt:

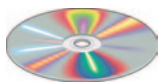
- Materials and Technologies
- Advanced Packaging & MEMS
- Interconnection Technologies and Substrates
- Semiconductor structures and Circuits
- Passive components, active devices & systems
- Electrical, thermal, mechanical and multi-physics simulations
- Microelectronic applications
- Reliability & quality

Auf der Webseite www.emps.com finden Sie alle Informationen zum Programm, dem Tagungsort, Registrierung etc.

Im Zusammenhang mit dem Symposium finden auch eine begleitende Ausstellung sowie ein Workshop zu *ferroelektrischer Dünn- und Dickschichtverarbeitung und deren Anwendung in MEMS* statt.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

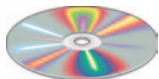
und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind noch als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender
c/o ZiK MacroNano
ZMN – Außenstelle Haus M
Am Helmholtzring 1
98693 Ilmenau
Fon: 03677/69-3381
Fax: 03677/69-3379
e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende
c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie
Egerlandstraße 88
D-73431 Aalen
Fon: 07361/931129
Fax: 07361/943004
e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister
c/o FH Rosenheim
Hochschulstraße 1
D-83024 Rosenheim
Fon: 08031/805-629
Fax: 08031/805-603
e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik

PF 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de

Analytische Praxis in der Elektronikfertigung

Baugruppenfertigung, Leiterplatten, Kunststoffgalvanik

Von Dr. Rolf Biedorf. Erste Auflage 2005. 696 Seiten mit 189 Abbildungen und 80 Tabellen.
ISBN 3-87480-211-6. Preis € 98,- incl. 7 % MwSt., zuzüglich Porto.

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Qualität von Produkten nimmt stetig zu. Dies macht den Einsatz aller modernen Analysemethoden für die Herstellverfahren und die Qualitätsprüfung der fertigen Produkte unumgänglich.

Dieses umfassende Handbuch berücksichtigt alle Methoden der nasschemischen Analytik, der Prüfung von Rohstoffen zur Herstellung sowie die Verfahren zur Bestimmung der notwendigen Qualitätsmerkmale von Elektronikprodukten. Für jede Messmethode ist die erforderliche Ausrüstung und Vorgehensweise für den Einsatz angegeben.

Für den Praktiker ein unersetzliches Arbeitsbuch in der Produktion und Qualitätsprüfung eines modernen Elektronikunternehmens.

Eugen G. Leuze Verlag

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10
e-mail: brigitte.brotzer@leuze-verlag.de · Internet: www.leuze-verlag.de